

技術詞彙表

「AAU」	指	有源天線單元
「ACF」	指	異方性導電膠膜
「AES」	指	主動式靜電感應技術
「AOFT」	指	柔性基板薄膜觸控
「AOI」	指	自動光學檢測
「AI」	指	人工智能
「BBU」	指	基帶處理單元
「BGA」	指	球柵陣列
「BMS」	指	電池管理系統
「CAF」	指	導電陽極絲
「CCD」	指	電荷耦合器件
「CNC」	指	計算機數控
「COB」	指	板上芯片封裝
「COG」	指	玻璃覆晶封裝
「CPO」	指	共封裝光學器件
「DR/FR」	指	近場／遠場
「DSP」	指	數字信號處理器
「DU」	指	分佈式單元
「EAM」	指	企業資產管理
「ECU」	指	電子控制單元
「EHS」	指	環境、健康及安全
「ELIC」	指	每層互連
「EMI」	指	電磁干擾
「EML」	指	電吸收調製激光器
「ERP」	指	企業資源規劃
「ESG」	指	環境、社會及管治
「EV」	指	電動汽車
「軟板」	指	柔性印刷電路
「FPCA」	指	柔性印刷電路組件
「FTTH」	指	光纖到戶

技術詞彙表

「F5G」	指	第五代固定網絡
「F5G-A」	指	第五代固定網絡增強版
「GF2」	指	雙面導電層玻璃單層薄膜
「GPU」	指	圖形處理器
「HDI」	指	高密度互連
「IIoT」	指	工業物聯網
「InP PIC」	指	磷化銦光子集成電路
「IoT」	指	物聯網
「LCD」	指	液晶顯示
「LCM」	指	液晶模組
「LPO」	指	線性可插拔光學器件
「LRO」	指	線性接收器光學器件
「MES」	指	製造執行系統
「多層PCB」	指	多層印刷電路板
「MSA」	指	多源協議
「mSAP」	指	改良型半加成法
「MPP」	指	微軟筆協議
「NRZ」	指	不歸零編碼
「NTSC」	指	國家電視系統委員會
「OECD」	指	經濟合作與發展組織
「OSFP」	指	八通道小型可插拔
「OCA」	指	光學透明膠黏劑
「OCR」	指	光學透明樹脂
「OEM」	指	原始設備製造商
「OLED」	指	有機發光二極管
「OLT」	指	光線路終端

技術詞彙表

「ONT」	指	光網絡終端
「ONU」	指	光網絡單元
「OTN」	指	光傳送網絡
「OTU」	指	光信道傳送單元
「PAM4」	指	四電平脈衝幅度調製
「PC」	指	個人計算機
「PCB」	指	印製電路板
「PLM」	指	產品生命週期管理
「PON」	指	無源光網絡
「QMS」	指	質量管理體系
「QSFP-DD」	指	四通道小型可插拔雙密度
「RAN」	指	無線電接入網絡
「硬板」	指	剛性印製電路板
「SDH」	指	同步數字體系
「SFP」	指	小型可插拔
「硅光」	指	硅光子學
「SMT」	指	表面貼裝技術
「SONET」	指	同步光網絡
「SRM」	指	供應商關係管理
「SR/VR」	指	短距離／超短距離
「STM-N」	指	N級同步傳輸模塊
「TFT」	指	薄膜晶體管
「USI」	指	通用手寫筆聯盟
「WCS」	指	倉庫控制系統
「WMS」	指	倉庫管理系統
「XGS-PON」	指	10G對稱無源光網絡